



PAN163 应用

Rev 1.0

Panchip Microelectronics

www.panchip.com

PANCHIP

目录

第 1 章 PAN163 应用原理图.....	3
第 2 章 ADC 校准测试内容.....	4
2.1 使用 PAN-LINK 烧录器进行 ADC 校准.....	4
2.2 ADC 内部校准.....	5
2.2.1 出厂两点式默认校准.....	5
2.2.2 内部 BGAP 和外部基准电压校准.....	5
第 3 章 系统时钟.....	6
3.1 系统时钟框图.....	6
3.2 外接 16Mhz 晶体.....	6
3.3 使用内部 RC.....	6
3.4 使用 XN297L 时钟.....	7
3.4.1 工作原理.....	7
3.4.2 使用方法.....	7
参考工程 OSC_XN297L.....	7
3.5 通过 XN297L 检测内部 RC 时钟.....	7
3.5.1 工作原理.....	7
3.5.2 使用方法.....	8

第1章 PAN163 应用原理图

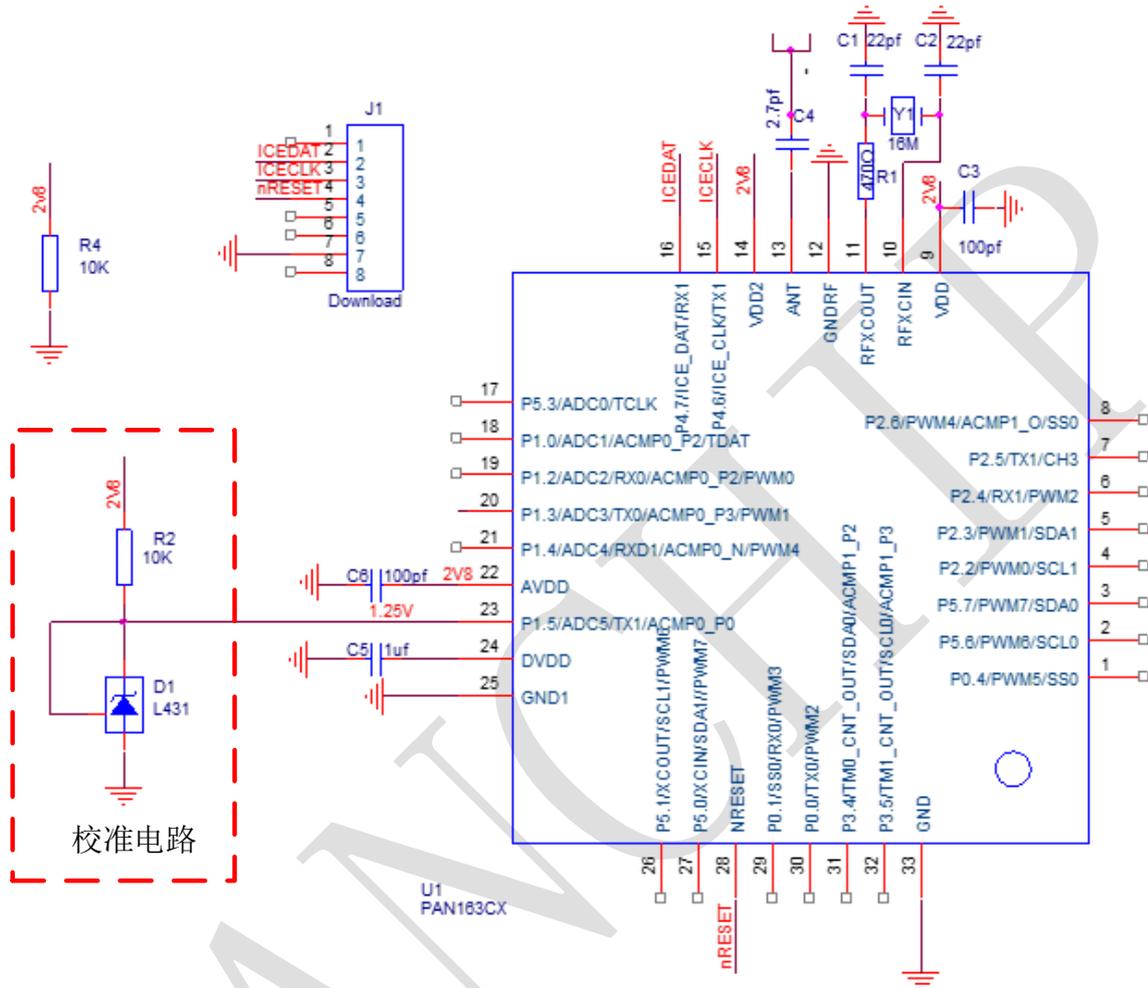


图 1 PAN163 应用原理图

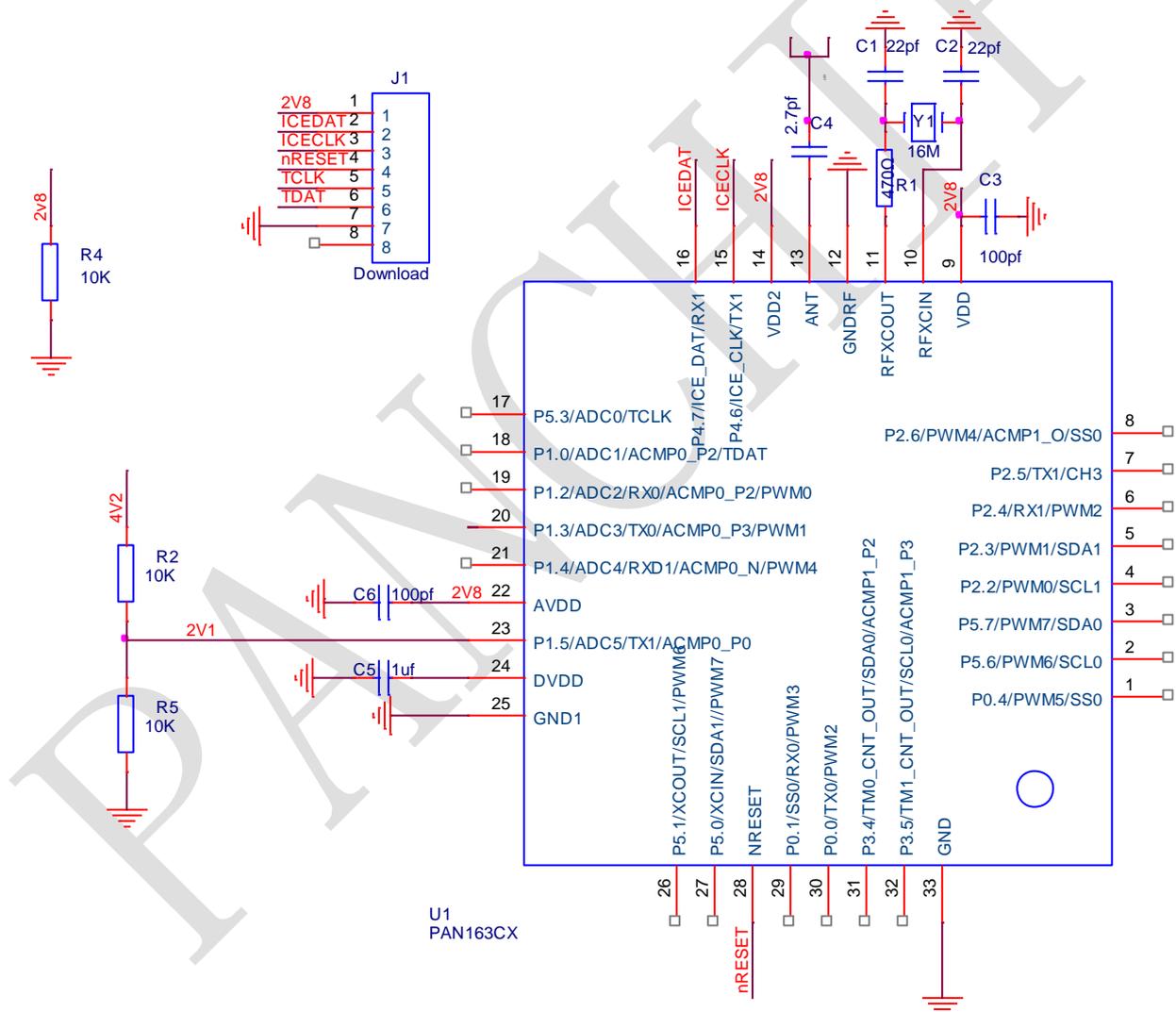
注意事项:

1. C1/C2 谐振电容，根据不同型号的晶振进行微调，推荐范围 15~36pF;
2. C4 推荐 2.7pF，可选择范围在 2~4pF;
3. NRESET 脚可以悬空，芯片衬底建议 GND;
4. MCU 供电为 2.4--2.8V;
5. P1.4 管脚外部输入电压不能超过(AVDD+0.3V);
6. 使用一个基准电压 1.25V 通道作为 ADC 校准;
7. R4 防止 IO 脚漏电;
8. 校准电路：如果应用场合需要很高的 ADC 精度（1%以内），需要添加这个电路，否则

可以不添加这部分电路。注意：校准电路的 L431 类的芯片（已测试芯片如 L431LM3B）精度要在 0.5% 以内，输出电压在 0.8-2.5V 直接都可以。参考库中工程 ADC_OSC_Calib

第2章 ADC校准测试内容

2.1 使用 PAN-LINK 烧录器进行 ADC 校准



ADC5 通道电压 $V_{ch}=2.1V$ ，电池电压为 $V_{bat}=4.2V$ 。在量产 8 线烧录时 V_{bat} 提供一个稳定高精度的电压源 4.2V，勾选 PAN-LINK ADC 校准功能。在烧录时 PAN163 会开启 ADC5，并将检测到的 ADC_CODE 存储在 UCID2 中。 $ADC_CODE=UCID2\&0XFFF$ ；改变电池电压为 V_{bat1} ，这时 ADC5 检测到的 ADC 值记为 ADC_CODE1 。 $V_{bat1}=2*2.1V*ADC_CODE1/ADC_CODE$ 。

ADC_CODE 存储在 UCID2 中的格式：烧录的时候 PAN-LINK 会将 12BIT 的 ADC_CODE 存储在 UCID2[0: 11],ADC_CODE 取反存储在 UCID2[12:23],UCID2[24:31]=0X50。

2.2 ADC 内部校准

2.2.1 出厂两点式默认校准

出厂时测试两个已知固定电压储存在 ID 区域。ADC 模式为 $Y=KX+B$ 。根据这两个 ID 值求出 K,B。参考工程 ADC_Calibrate。ADC 测试电压范围推荐为 1.1V-2.4V,精度可达 3%。

2.2.2 内部 BGAP 和外部基准电压校准

推荐使用

- A. ADC 模型为 $Y=KX+B$
- B. $Y=KX$,使用内部基准电压测试出系数 K.

ADC 模型 $V=K*CODE$;V 电压值; K:ADC 比例系数, Xcode 表示 ADC 转换结果(0--4095)。内部 BGAP 为恒定不变电压。 $V_{bgap}=k*CODE_{bgap}$;芯片在出厂时给芯片供恒定电压 2730mv,使用 ADC 测试出 BGAP 值,记为 BGAP_CODE_UID0;当前供电情况想,测试 BGAP 电压记为 bgap_code, $k=2730/4095*BGAP_CODE_UID0/bga_code$ 。

待测通道电压值 $V_x=X_CODE*2730/4095*BGAP_CODE_UID0/bga_code$ 。ADC 测试电压范围推荐为 1.1V-2.4V,此时不加基准电压,精度可达 3%。

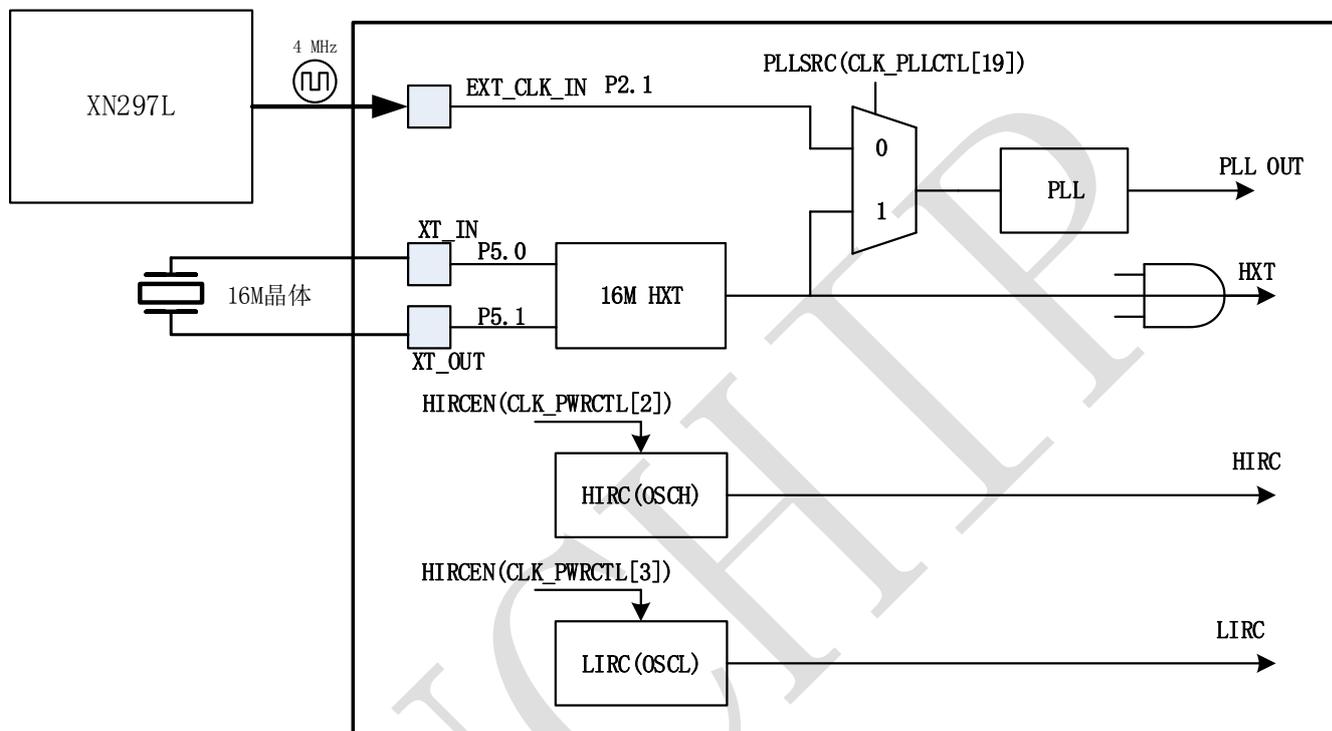
- C. 根据外部基准电压算出 B

如果要求 ADC 精度为 1%，添加图 1 中校准电路。使用外部电压来消除 ADC 偏差 B。

参考工程 ADC_OSC_Calib。

第3章 系统时钟

3.1 系统时钟框图



PAN163 系统时钟源框图

系统时钟源选择有三种方式：

1. 外接 16Mhz 晶体作为系统时钟
2. 使用内部 RC 作为系统时钟（有 48Mhz 和 55Mhz 两档）
3. XN297L 输出 4M 时钟经过 PLL 倍频到 48Mhz 作为系统时钟

3.2 外接 16Mhz 晶体

- 1、直接将 16M 时钟作为系统时钟，使用库函数 `CLK_InitHXT ()`
- 2、经过 PLL 将 16M 时钟倍频到 48Mhz，使用库函数 `CLK_InitHXTPLL ()`

3.3 使用内部 RC

芯片内部有可调高频 RC 振荡器，范围为 20—60Mhz，出厂时将内部 RC 分别校准到 48Mhz(1.1% 精度) 和 55Mhz (1%精度)。

- 1、48Mhz 档：调用库函数 `CLK_InitHIRC ()`
- 2、55Mhz 档：定义宏 `__HIRC_55M__` 并调用库函数 `CLK_InitHIRC ()`

3.4 使用 XN297L 时钟

3.4.1 工作原理

XN297L 输出 4M 时钟经过 PLL 倍频到 48Mhz 作为系统时钟。MCU 使用内部 RC 启动芯片，使 XN297L 一直输出 4Mhz 的方波时钟，MCU 系统时钟切换到外部时钟。

XN297L 输出时钟条件：

- 1、RF_CAL 的 bit 23 (EN_CLK_OUT) 配置为 1
- 2、RF_CAL2 的 bit <35:34> (CLK_SEL) 配置 10: 4MHz
- 3、XN297L 处于 RX/TX/STB2 状态 (即 CE 为高)。发送端 TX FIFO 寄存器为空并且 CE 引脚置 1，进入 STB2(预发射状态)。

3.4.2 使用方法

参考工程 OSC_XN297L

- 1、初始化内部时钟

```
SYS_UnlockReg();
```

```
CLK_InitHIRC();
```

2. rf_init

```
CE_HIGH
```

```
BB_cal_data[] = {0x0A,0x6D,0x67,0x9C,0x46}; //1M 下 rf 配置
```

```
RF_cal_data[] = {0xF6,0x37,0xDD
```

```
RF_cal2_data[] = {0x45,0x21,0xef,0xAC,0x5A,0x50};
```

```
Dem_cal_data[] = {0x01};
```

```
Dem_cal2_data[] = {0x0b,0xDF,0x02};
```

```
RX_MODE()
```

- 3.切换到外部时钟

```
CLK_InitExtOSC4MPLL()
```

```
SYS_LockReg();
```

3.5 通过 XN297L 检测内部 RC 时钟

3.5.1 工作原理

内部 RC 在出厂时已校准到 1%，如果能够知道具体 RC 时钟频率那么将减少软件计算误差。

检测内部 RC 时钟方法：内部 RC 做系统时钟，XN297L 输出 2M 的方波到 IO 脚 P2.1。MCU 开启定时器,同时 IO 脚 P2.1 采集固定的方波个数.通过读取定时器的计数值来判断内部 RC 的大小，更新 SystemCoreClock 变量。

3.5.2 使用方法

参考工程 *OSC_XN297L_CALIB*

1.启动系统时钟

```
SYS_UnlockReg();
```

```
CLK_InitHIRC();
```

```
SystemCoreClockUpdate();
```

2.校准变量 SystemCoreClock

```
CLK_Calibrate();
```